

# 第 39 回 電子デバイス実装研究委員会

日時：2022 年 9 月 5 日（月）13:00～16:50

場所：大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス B3 棟-117 講義室

～カーボンニュートラルに向けた接合・実装技術～

## プログラム

---

司会 高尾 尚史 (株)豊田中央研究所

**13:00-13:40**

『循環型熱硬化性樹脂によるサーキュラーエコノミー戦略』(40分)

..... ○内藤 昌信 ((国研)物質・材料研究機構)

**13:40-14:20**

『リフトオフを生じない高耐久はんだ』(40分)

..... ○森 公章、大谷 怜史、岡村 眞 ((株)弘輝)

14:20～14:30 休憩

司会 佐名川 佳治 パナソニック(株)

**14:30-15:10**

『三次元実装の現状と課題』(40分) ..... ○西田 秀行 (NEP Tech. S&S)

**15:10-15:50**

『深層学習を利用した非破壊でのはんだクラック三次元可視化と進展解析』(40分)

..... ○長谷川 将司、植木 竜佑、高橋 政典 ((株)クオルテック)

15:50～16:00 休憩

司会 井上 雅博 群馬大学

**16:00-16:40**

『AKROSE と拡散接合を組み合わせた接合技術「AKROSE HYBRID」の開発』(40分)

..... ○手島 政和 (日東精工(株))

**16:40～16:50** 委員会議事

( ) 内時間は、質疑応答時間を含む

---

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会